

RAITECH®

ARA:MAX® GOLD MPTK270Z



la empaquetadura híbrida,
de alto desempeño.

200bar / 260°C / 20ms

VERSATILIDAD. DESEMPEÑO. PUREZA.

ROBUSTAS. DURABLES. PROFESIONALES

FUSIÓN DE QUÍMICA Y MECANICA DE OTRO NIVEL.

Empaquetadura de construcción inter-trenzada a partir de una fusión de fibras **FLUORO:GRAF® 2.5+** basadas en PTFE Y grafito amorfo encapsulado y fibras **ARA:MAX® GOLD** basadas en aramida, con mejoras sustanciales a las fibras comunes en el mercado.

Resiste temperaturas desde -210°C hasta $+288^{\circ}\text{C}$. A su vez puede trabajar en aplicaciones de altas velocidades de hasta 20m/s gracias a los aditivos minerales de alta temperatura auto-lubricantes que ayudan a disipar mejor el calor.

La empaquetadura **ARA:MAX® COBRA** es capaz de resistir la mayoría de los productos químicos dentro del rango de pH 2-12 (con la excepción metales alcalinos fundidos y flúor elemental)

La empaquetadura **ARA:MAX® COBRA** es una empaquetadura de uso universal para todo tipo de equipos industriales, tanto dinámicas como estáticas.

Empaquetadura recomendada para servicios en cualquier tipo de bombas, mezcladores, reactores, vástago de válvulas, entre otros.



www.raitech.mx

RAITECH DATOS TECNICOS: MPTK:270Z



Presión Max.
200 bar (2900psi)
Valvulas:
30 bar (435psi)
Bombas reciprocantes:
200 bar (2900psi)



Temperatura Max.
 -210°C
(-346°F)
 $+288^{\circ}\text{C}$
(550°F)



Velocidad del eje
20m/s

pH

Rango de pH
2-12

*** PARAMETROS NO ASOCIADOS

PRESENTACIONES:

Medida	Presentación Estándar	Longitud (mts/kg)
1/8"	2.3kgs	—
3/16"	2.3kgs	—
1/4"	2.3kgs	16
5/16"	2.3kgs	11
3/8"	2.3kgs	7.5
7/16"	2.3kgs	5.2
1/2"	2.3kgs	4.3
9/16"	5kgs	3.5
5/8"	5kgs	2.7
3/4"	5kgs	2
7/8"	5kgs	1.5
1"	5kgs	1

TODOS LOS MATERIALES VIENEN DEBIDAMENTE MARCADOS CON LA MARCA Y ESTILO CORRESPONDIENTE. NO SURTIMOS MATERIALES SIN MARCA



***Consúltanos para medidas milimétricas y mayor a 1 pulgada.

Toda la información técnica y de seguridad de los productos RAITECH se basa en la experiencia y el conocimiento de los expertos en el campo de la tecnología de empaquetadura. RAITECH no se responsabiliza por los daños o lesiones que puedan ocurrir al utilizar los productos RAITECH en aplicaciones críticas o donde exista duda. RAITECH no se responsabiliza por los daños o lesiones que puedan ocurrir al utilizar los productos RAITECH en aplicaciones críticas o donde exista duda.